

【特徴】SR 下地の基板樹脂表面に傷が残っている状態の欠陥

【特征】SR 基底的树脂表面有损伤的缺陷。

【Characteristics】A scratch left on the laminate surface under the solder resist

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 布塗前の基板樹脂部に、何かが接触したり、静電気破壊したりして出来たもの（回路形成後～SR印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】涂布 SR 前的树脂层接触某种物体，或者静电破坏而引起的（图形转移后～SR印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by a contact of an object with the laminate or the destruction by electrostatic discharge before solder resist application (Forming conductive pattern - solder resist application)



【コメント】
導体表面に出来た静電
傷が樹脂部にまでのび
ている（透過写真）
顕微鏡倍率×

【注釋】
導線表面の静电破壊の
伤痕延長到树脂层（投
射照片）
显微镜倍率 ×

【Comments】

Scratch caused by electrostatic discharge on the conductor surface is extending to laminate area. (transmission photo)
Magnification: ×



【コメント】
導体部及び樹脂部にも
傷あり
顕微鏡倍率×

【注釋】
導線以及树脂层也有伤
痕 显微镜倍率 ×

【Comments】
Scratch on conductor
area and laminate area
Magnification: ×

2-1-2-34 カバーレイ下地銅箔変色 / 覆盖层基底的铜箔变色 / Discoloured copper foil under coverlay

【特徴】カバーレイ下地銅箔表面に変色が見られる状態の欠陥

【特征】在覆盖层基底的铜箔表面可见变色的缺陷。

【Characteristics】Copper foil under coverlay is discoloured.

【原因・判断ポイント・発生工程】回路形成後のFPC銅箔表面に薬液などの異物が付着した状態でカバーレイが貼り付けられ、その後の加熱工程で熱を受けて出来たもの（回路形成工程後～）

【原因、判断要点、发生工序】在图形转移后的FPC銅箔表面附着药液等杂物，然后压合覆盖膜，在加热工序受热而引起的（图形转移工序后～）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】A coverlay is applied over a FPC conductor surface contaminated with a foreign material such as chemicals. The discolouration of FPC is developed on heating in the subsequent heating process. (After forming conductive pattern -)



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×